

DT-CuAg

kupferbasis. MSG-Drahtelektrode WIG-Schweißstäbe

Normbezeichnung

EN ISO 24373: S Cu 1897 (CuAg1)

Anwendungsbereich

Verbindungsschweißen von Reinkupfer
Kupfer-Silber-Legierungen

Das Schweißgut zeichnet sich durch eine gute
Polierfähigkeit aus.

MIG: geeignet	WIG: empfohlen	GAS: empfohlen
------------------	-------------------	-------------------

Richtanalyse des Drahtes (%)

Cu : Basis Ag: 0,80-1,20 P: 0,01 Mn: 0,10

Mech. Gütwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

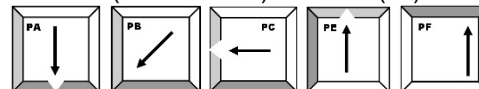
0,2% Dehngrenze (Rp0,2) 80 N/mm²
Zugfestigkeit (Rm) 230 N/mm²
Dehnung (A)(Lo=5do) 18 %
Härte Brinell 60

Zulassungen

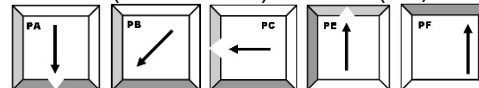
auf Anfrage

Schutzgase/Polung

WIG: (ISO 14175) I1 (= -)



MSG: (ISO 14175) I1 (= +)



Grundwerkstoffe

2.0076 2.0090 2.0040
sauerstoffreies Kupfer

Lieferprogramm

MIG: gespult auf D100 / D200 / K 200 / K 300
WIG: verpackt in Karton a 10kg